

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-32

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	华泰证券
上市公司接待人员	证券事务主管：阳佩琴
时间	2025年9月26日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 2025 年半年度经营业绩情况。</b></p> <p>2025 年上半年，在人工智能技术革新的驱动下，电子电路行业持续显现出结构性增长机会。报告期内，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 25.63%，归母净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。上述变动主要得益于公司把握 AI 算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化增长机遇，实现了三项主营业务收入的同比增长。与此同时，得益于 AI 加速卡、服务器及相关配套产品等需求持续提升，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，产品结构持续优化，助益利润同比提升。</p> <p><b>Q2、请介绍 2025 年上半年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。</b></p> <p>PCB 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p>2025 年上半年，PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%；业务毛利</p>

率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点。PCB 业务把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。营收层面的增长贡献主要为 AI 加速卡等产品需求释放，数据中心领域占比进一步提升；400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著提升，有线侧占比增加；以及汽车电子需求增长。毛利率在营收规模增加、产能利用率相对高位、产品结构优化的情况下亦有所提升。

**Q3、请介绍 2025 年上半年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。**

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。

2025 年上半年，封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点。公司封装基板业务把握国内存储市场增长的机遇，加大市场拓展力度，推动订单较去年同期显著增长。封装基板业务毛利率同比下降，主要由于广州封装基板项目处于产能爬坡阶段，金盐等部分原材料涨价，使得成本及费用较同期增加。

**Q4、请介绍公司上半年工厂产能利用率情况。**

公司 PCB 业务因算力及汽车电子市场需求持续提升，工厂综合产能利用率处于相对高位；封装基板业务受国内存储市场的需求明显提升，工厂综合产能利用率同比明显改善。

**Q5、PCB 新产能建设情况。**

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目均设有工厂。PCB 新增产能主要来自新建工厂和原有工厂技术改造，其中新建工厂包括南通四期和泰国工厂，南通四期预计今年四季度连线，泰国工厂目前已连线；同时，公司也通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能。

**Q6、请介绍广州封装基板项目连线及产能爬坡进展。**

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡阶段，重点仍聚焦能力建设及市场开发，2025 年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。

	<p><b>Q7、请介绍公司 PCB 业务在 AI 算力方面的布局情况。</b></p> <p>伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。2024 年以来，公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受益于上述趋势。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>